

[会員限定] 2023年度第4回 先端半導体パッケージWG研究会

【会場】大阪大学産業科学研究所
インキュベーション棟1階 講義室(I-117)

2023年

12/22(金) 13:30~19:00

13:30-13:35 開会挨拶 菅沼克昭 所長・特任教授 大阪大学産業科学研究所F3D実装協働研究所

13:35-13:45 チップレット集積と平坦化技術 山中公博 教授 中京大学工学部

13:45-15:15 CMPの原理と応用～パッケージ技術への展開



講師：磯部 晶氏 株式会社ISTL 代表取締役
博士(工学)

導入当初はゲテモノ扱いされていたCMPプロセスだが、今や先端ロジック製品では50を超える工程で適用されているという。その理由は、微細化が減速している中で、高集積化・高性能化のトレンドを維持するためには、デバイス構造の三次元化が必要であり、その実現にCMPが重要な役割を果たしているからである。CMPの適用は前工程に留まらず、パッケージ工程にも及んでいる。本講では、CMPの原理とその要素である装置、材料技術、さらにその応用技術について解説する。

15:15-15:25 休憩・講師との名刺交換会

15:25-16:05 CMP装置の特徴と近年の課題



講師：岩佐 毅彦氏 株式会社荏原製作所 精密・電子カンパニー
装置事業部 技術マーケティング課 課長

CMP装置は先端半導体デバイス製造にあたり、重要な役割を担う半導体製造装置の一つです。本講演では世界的に主要なCMP装置メーカーである荏原製作所より、CMP事業の沿革と共にCMP装置の基本構成と特徴、先端パッケージ分野を含む近年のCMP課題と対応の方向性について解説します。

16:05-16:45 (株)D-processの試作の特徴 および実績



講師：山崎 努氏 株式会社D-process CMPファンダリー事業部 リーダー
博士(工学)

CMP受託加工からビジネスを開始した(株)D-processは、本年6月で20周年を迎えました。今後もCMP技術をはじめ、めっき・接合などの関連プロセスへのサービスを展開し、研究開発・試作から小ロット生産・技術移管に至るまでお客様のニーズにお応えしてまいります。本講演では基本となるCMP試作事例から、接合前処理・イオントリム・先端基板加工などの応用技術に関して実例を挙げつつ紹介いたします。

17:00-19:00 講師を交えた意見交換会

申し込み・問い合わせ 大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 先端半導体パッケージWG事務局
(TEL/FAX:06-6879-4295/E-mail:yamaha.takahisa@sanken.osaka-u.ac.jp) 山葉隆久

主催：大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 後援：一般財団法人大阪大学産業科学研究協会